

超高真空金屬與金屬氧化物奈米級薄膜濺鍍系統

能力考核表

- ※ 設備使用前之確認與檢查
 - 1. 確認機台各腔體目前狀況.....
 - 2. 機台各腔體功能說明.....
- ※ 8”與 12”晶圓製程之硬體設定確認.....
 - 1. De-chuck 設定.....
 - 2. Notch 設定.....
 - 3. Chamber B Lift pin 設定.....
- ※ 軟體操作.....
- ※ 製程 recipe & sequence 之參數與流程說明
 - 1. recipe 參數與流程說明.....
 - 2. Sequence 流程說明.....
 - 3. Flow 設定.....
- ※ 晶片放入及取出的步驟、FOUP 放置及拿取.....
- ※ Load & Unload、製程 Lot 設定、製程啟動指令
 - 1. 操作 FI.....
 - 2. 製程 Lot 設定.....
 - 3. 製程啟動/暫停指令.....
- ※ 緊急(alarm)情況處理
 - 1. FI alarm 處理.....
 - 2. 腔體硬體 alarm 處理.....
 - 3. 掉片/破片處理.....
 - 4. 警緊按鈕操作時機.....